

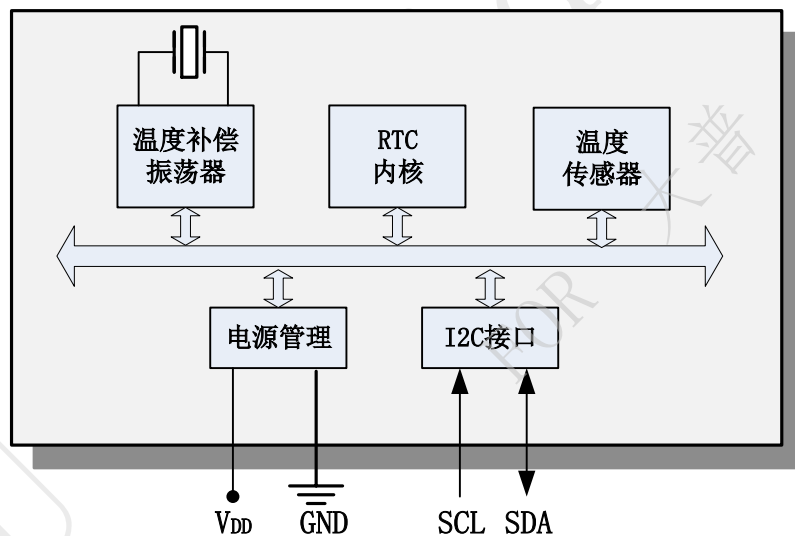


## INS5710C — I<sup>2</sup>C 低功耗温补 RTC 实时时钟芯片

### 特性

- 低功耗: 1.0uA(典型值)
- 稳定性:  
5±20ppm @ -40°C~85°C
- 内置晶体: 32.768kHz
- 内置温度传感器
- 通信接口类型: I<sup>2</sup>C 总线接口
- 电压输入范围: 1.6V ~ 5.5V
- 温度范围: -40°C~+85°C
- 闰年自动调整功能
- 封装尺寸: 4.9mm × 6.0mm × 1.6mm

### 原理框图



### 说明

INS5710C 是一款低功耗带温度补偿功能的实时时钟芯片，内置 32.768KHz 晶振。具有 I<sup>2</sup>C 通信接口，支持日历（年，月，日，时，分，秒）功能。采用贴片 SOP8 封装，适用于三表、便携式终端及其他小型电子仪器等。



### 修订记录表

版本	修改内容	起草	修正日期
V1.0	发布		2022.03.07
V1.1	图 5, 包装信息完善		2022.04.20



# 目录

<b>1</b>	<b>产品概述</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>原理框图</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>特性</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>管脚定义</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>电气特性</b> .....	<b>7</b>
5.1	绝对参数.....	7
5.2	额定工作参数.....	7
5.3	频率特性.....	7
5.4	直流电气特性.....	8
5.5	交流特性.....	9
<b>6</b>	<b>用户寄存器</b> .....	<b>10</b>
6.1	寄存器列表.....	10
6.2	寄存器详细描述.....	11
6.2.1	时间.....	11
6.2.2	扩展寄存器.....	13
6.2.3	标志寄存器.....	13
6.2.4	控制寄存器.....	13
6.2.5	温度寄存器.....	13
6.2.6	保留寄存器.....	13
6.2.7	Device ID 寄存器.....	13
6.2.8	控制寄存器 1.....	14
6.2.9	亚秒时间寄存器.....	14
<b>7</b>	<b>I<sup>2</sup>C 总线接口</b> .....	<b>15</b>
7.1	注意事项.....	15
7.2	总线地址.....	15
7.3	总线协议.....	15
7.3.1	写序列.....	15
7.3.2	读序列.....	16



---

8	封装尺寸图.....	18
9	回流焊曲线.....	19
10	包装信息 .....	20

DAPU Confidential  
FOR 大普



## 1 产品概述

INS5710C 是一款低功耗，带温度补偿的实时时钟芯片，内置 32.768KHz 晶振。具有 I<sup>2</sup>C 通信接口，支持日历（年，月，日，时，分，秒）功能。采用贴片 SOP8 封装，适用于安防、便携式终端及其他电子仪器等。

## 2 原理框图

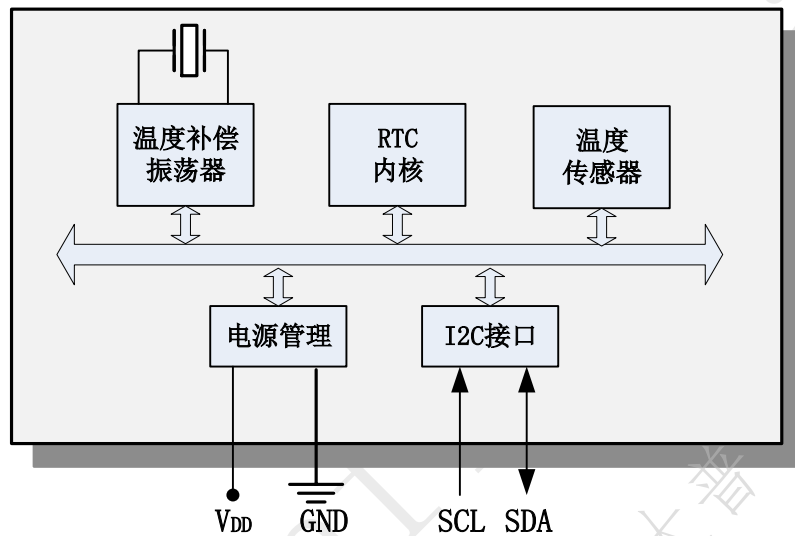


图 1 原理框图

## 3 特性

- 低功耗：1.0uA(典型值)
- 高稳定性：  
 $5 \pm 20\text{ppm} @ -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
- 内置晶体：32.768kHz
- 通信接口类型：I<sup>2</sup>C 总线接口
- 电压输入范围：1.6V ~ 5.5V
- 温度范围：-40°C ~ +85°C
- 闰年自动调整功能
- 封装尺寸：4.9mm × 6.0mm × 1.6mm



## 4 管脚定义

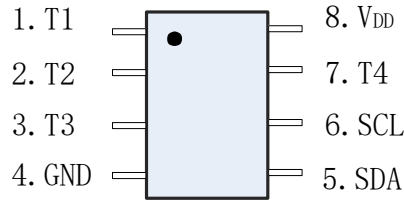


表1. 管脚定义

管脚号	管脚名称	I/O 方向	说明
1	T1		厂家测试, 必须悬空
2	T2		厂家测试
3	T3		厂家测试
4	GND	-	电源地
5	SDA	In/Out	I <sup>2</sup> C 数据信号
6	SCL	In	I <sup>2</sup> C 时钟信号
7	T4		厂家测试, 必须悬空
8	V <sub>DD</sub>	-	主电源输入



## 5 电气特性

### 5.1 绝对参数

表2. 绝对参数

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
主电源	V <sub>DD</sub>	-0.3		6.5	V	
I/O 输入电压	V <sub>IN</sub>	GND-0.3		6.5	V	SCL, SDA 输入
I/O 输出电压	V <sub>OUT1</sub>	GND-0.3		6.5	V	SDA 输出
储存温度	T <sub>STG</sub>	-55		125	°C	

### 5.2 额定工作参数

表3. 额定工作参数

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
主电源(常规模式)	V <sub>DD</sub>	2.5	3.0	5.5	V	
主电源(时间保持)	V <sub>DD</sub>	1.6	3.0	5.5	V	*
工作温度	T <sub>OPR</sub>	-40	25	85	°C	

\* 注: 在上电起振时间内, 必须提供 2.5V 以上电压确保振荡电路稳定起振。

注: 电源断电后, 保证 VDD=GND 超过 10 秒, 然后再上电。

注: 没有特殊标明时, 测试条件为 GND=0V, V<sub>DD</sub>= 2.5V~5.5V, T<sub>a</sub>=-40°C~+85°C

### 5.3 频率特性

表4. 频率特性

参数	符号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
频率稳定度	$\Delta f_1/f$	5±20			ppm	V <sub>DD</sub> =3.0V; -40°C~+85°C;
起振时间	t <sub>STA</sub>			1	s	@25°C
年老化	f <sub>a</sub>			±3	ppm	第一年@25°C

注: 没有特殊标明时, 测试条件为 GND=0V, V<sub>DD</sub>= 2.5V~5.5V, T<sub>a</sub>=-40°C~+85°C



## 5.4 直流电气特性

表5. 直流特性

参数	符号	数值			单位	备注	
		最小值	典型值	最大值			
平均电流 1	$I_{DD1}$		1.25	5.1	uA	$V_{DD}=5.0V$	f <sub>SCL</sub> =0Hz, 输入信号为低。
平均电流 2	$I_{DD2}$		1.0	4.9		$V_{DD}=3.0V$	
输入高电平	$V_{IH}$	$0.8 \cdot V_{DD}$		5.5	V	SCL, SDA 脚	
输入低电平	$V_{IL}$	GND-0.3		$0.2 \cdot V_{DD}$	V		
输出低电平	$V_{OL1}$	GND		GND+0.4	V	$V_{DD} \geq 3.0V, I_{OL} = 3mA$	SDA 脚
输入漏电流	$I_{LK}$	-0.1		0.1	uA	SDA, SCL 脚, $V_{IN} = V_{DD}$ 或 GND	
输出漏电流	$I_{OZ}$	-0.1		0.1	uA	SDA 脚, $V_{IN} = V_{DD}$ 或 GND	

注：没有特殊标明时，测试条件为 GND=0V,  $V_{DD}= 2.5V \sim 5.5V$ ,  $T_a=-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$





## 5.5 交流特性

表6. 交流特性

$V_{DD} = 2.5V \sim 5.5V$ ;  $T_a = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

参数	符号	数值			单位
		最小值	典型值	最大值	
SCL 时钟频率	$f_{SCL}$			400	kHz
SCL 低电平时间	$t_{LOW}$	1.3			us
SCL 高电平时间	$t_{HIGH}$	0.6			us
开始条件保持时间	$t_{HD:STA}$	0.6			us
开始条件建立时间	$t_{SU:STA}$	0.6			us
停止条件建立时间	$t_{SU:STO}$	0.6			us
从停止到开始的恢复时长	$t_{RCV}$	1.3			us
数据建立时间	$t_{SU:DAT}$	100			ns
数据保持时间	$t_{HD:DAT}$	0			ns
SCL, SDA 输入上升时间	$t_r$			0.4	us
SCL, SDA 输入下降时间	$t_f$			0.4	us

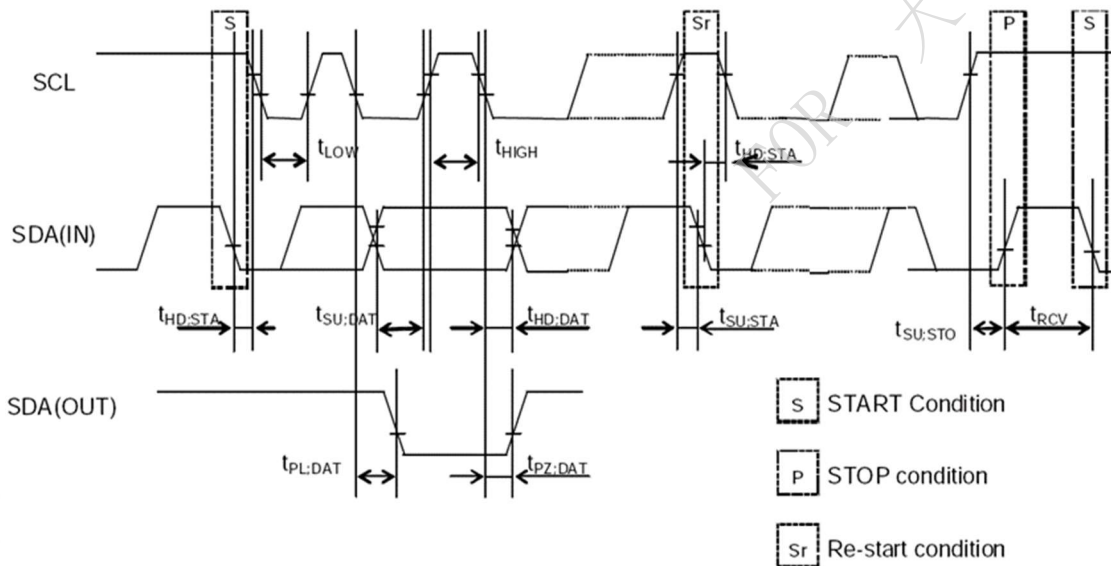


图 2 I<sup>2</sup>C 时序图



## 6 用户寄存器

### 6.1 寄存器列表

地址 0x00~0x0F: 基本时间和日历寄存器。

地址 0x10~0x1F: 扩展寄存器组 1。

地址 0x20~0x30: 扩展寄存器组 2。

\* 注: 0x10~0x16 与 0x00~0x06 完全相同, 0x1B~0x1F 与 0x0B~0x0F 完全相同。

表7. 基本时间和日历寄存器列表

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	读/写
0x00	SEC	○	BCD 码, 秒十位, 0-5			BCD 码, 秒个位, 0-9				R/W
0x01	MIN	○	BCD 码, 分十位, 0-5			BCD 码, 分个位, 0-9				R/W
0x02	HOUR	○	○	BCD 码, 时十位, 0-2		BCD 码, 时个位, 0-9				R/W
0x03	WEEK	○	6	5	4	3	2	1	0	R/W
0x04	DAY	○	○	BCD 码, 日十位, 0-3			BCD 码, 日个位, 0-9			R/W
0x05	MONTH	○	○	○	BCD 码, 月十位, 0-1		BCD 码, 月个位, 0-9			R/W
0x06	YEAR	BCD 码, 年十位, 0-9				BCD 码, 年个位, 0-9				R/W
0x07	RAM	●	●	●	●	●	●	●	●	R/W
0x08	RSV	保留位								R
0x09	RSV	保留位								R
0x0A	RSV	保留位								R
0x0B	RSV	保留位								R
0x0C	RSV	保留位								R
0x0D	Extension Register	TEST	保留位	保留位	保留位	●	●	保留位	保留位	R/W
0x0E	Flag Register	○	○	保留位	保留位	保留位	○	VLF	保留位	R/W
0x0F	Control Register	保留位	保留位	保留位	保留位	保留位	○	○	RESET	R/W

表8. 扩展寄存器组列表 1

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	读/写
0x10	SEC	○	BCD 码, 秒十位, 0-5			BCD 码, 秒个位, 0-9				R/W
0x11	MIN	○	BCD 码, 分十位, 0-5			BCD 码, 分个位, 0-9				R/W
0x12	HOUR	○	○	BCD 码, 时十位, 0-2		BCD 码, 时个位, 0-9				R/W
0x13	WEEK	○	6	5	4	3	2	1	0	R/W
0x14	DAY	○	○	BCD 码, 日十位, 0-3			BCD 码, 日个位, 0-9			R/W
0x15	MONTH	○	○	○	BCD 码, 月十位, 0-1		BCD 码, 月个位, 0-9			R/W
0x16	YEAR	BCD 码, 年十位, 0-9				BCD 码, 年个位, 0-9				R/W
0x17	TEMP	128	64	32	16	8	4	2	1	R



地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	读/写
0x18	RSV	○	○	○	○	保留位	●	●	●	R/W
0x19	Not use	○	○	○	○	○	○	○	○	R
0x1A	Not use	○	○	○	○	○	○	○	○	R
0x1B	RSV	保留位								R
0x1C	RSV	保留位								R
0x1D	Extension Register	TEST	保留位	保留位	保留位	●	●	保留位	保留位	R/W
0x1E	Flag Register	○	○	保留位	保留位	保留位	○	VLF	保留位	R/W
0x1F	Control Register	保留位	保留位	保留位	保留位	保留位	○	○	RESET	R/W

表9. 扩展寄存器组列表 2

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	读/写
0x20	Device ID	VendorID[3:0]				Ver[3:0]				R
0x21	Control Register 1	保留位: 确保固定为 0x8				○	○	○	●	R/W
0x22-26	RSV	保留位: 确保固定为 0x00								R
0x27	EvSubSEC&Sub SEC	保留位				SubSEC[3:0]				R
0x28-30	RSV	保留位: 确保固定为 0x00								R/W

注:

1. 在上电初始化（从 0V）或 VLF 位为 1 之后，确保初始化所有的寄存器之后再使用 RTC。
2. 上电初始化期间，寄存器的默认值如下：
  - 初始值为 0: TEST、RESET。
  - 初始值为 1: VLF。
  - 其他寄存器值为不确定值，所以确保在使用前进行复位。
3. 标记为“○”的位，初始化后读数为 0。
4. 标记为“●”的位为 RAM，可以用来读写任意数据。
5. 这些位只能写 0: VLF。
6. TEST 位被厂家用于测试，该位在写操作的时候请一定确保为“0”。保留位被厂家用于测试，写操作的时候请一定确保按照要求固定输入。

## 6.2 寄存器详细描述

### 6.2.1 时间

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0x00/10	SEC	○	BCD 码，秒十位，0-5			BCD 码，秒个位，0-9				0x00
0x01/11	MIN	○	BCD 码，分十位，0-5			BCD 码，分个位，0-9				0x00



地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0x02/12	HOUR	○	○	BCD 码, 时十位, 0-2		BCD 码, 时个位, 0-9				0x00

SEC: 秒, BCD 码格式, 数值 0~59 循环递增。

MIN: 分钟, BCD 码格式, 数值 0~59 循环递增。

HOUR: 小时, BCD 码格式, 数值 0~23 循环递增。

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0x03/13	WEEK	○	6	5	4	3	2	1	0	0x40

WEEK: 周, 按 bit 指示, 对照表如下, 数值按 01h、02h、04h、08h、10h、20h、40h 循环:

表10. WEEK 寄存器值对照表

星期	Data	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
日	01h	0	0	0	0	0	0	0	1
一	02h	0	0	0	0	0	0	1	0
二	04h	0	0	0	0	0	1	0	0
三	08h	0	0	0	0	1	0	0	0
四	10h	0	0	0	1	0	0	0	0
五	20h	0	0	1	0	0	0	0	0
六	40h	0	1	0	0	0	0	0	0

同时只能有 1bit 置 1

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0x04/14	DAY	○	○	BCD 码, 日十位, 0-3		BCD 码, 日个位, 0-9				0x01

DAY: 日, BCD 码格式, 支持大小月、闰年 (2000~2099 年), 数值循环递增, 数值范围见下表:

表11. DAY 寄存器数值范围

月份	数值范围
1, 3, 5, 7, 8, 10, 12	1~31 递增
4, 6, 9, 11	1~30 递增
2月 (平年)	1~28 递增
2月 (闰年)	1~29 递增

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0x05/15	MONTH	○	○	○	BCD 码, 月十位, 0-1	BCD 码, 月个位, 0-9				0x01
0x06/16	YEAR	BCD 码, 年十位, 0-9				BCD 码, 年个位, 0-9				0x00

MONTH: 月, BCD 码格式, 数值 1~12 循环递增。

YEAR: 年, BCD 码格式, 数值 0~99 循环递增。对应 2000~2099 年。

例如: 2020/01/01 Wednesday 21:18:36

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x00/10	SEC	○	0	1	1	0	1	1	0
0x01/11	MIN	○	0	0	1	1	0	0	0
0x02/12	HOUR	○	○	1	0	0	0	0	1



地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x03/13	WEEK	○	0	0	0	1	0	0	0
0x04/14	DAY	○	○	0	0	0	0	0	1
0x05/15	MONTH	○	○	○	0	0	0	0	1
0x06/16	YEAR	0	0	1	0	0	0	0	0

## 6.2.2 扩展寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0x0D/1D	Extension Register	TEST	保留位	保留位	保留位	●	●	保留位	保留位	0x02

TEST: 厂家测试位, 必须为“0”, 禁止用户修改。

## 6.2.3 标志寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0x0E/1E	Flag Register	○	○	保留位	保留位	保留位	○	VLF	●	0x03

VLF (Voltage Low Flag): 电压低标志, 当电压低于 1.6V 时置“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

## 6.2.4 控制寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0x0F/1F	Control Register	保留位	保留位	保留位	保留位	保留位	○	○	RESET	0x40

RESET: 准备同步时间的起点。

## 6.2.5 温度寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0x17	TEMP	128	64	32	16	8	4	2	1	0x00

可以读取数字化温度数据, 按如下公式计算:

$$\text{温度} [^{\circ}\text{C}] = (\text{TEMP}[7:0] * 2^{-187.19}) / 3.218$$

## 6.2.6 保留寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0x18	Reserved	○	○	○	○	Reserved	●	●	●	0x00

该寄存器为保留寄存器, bit3 建议设置为“0”。

## 6.2.7 Device ID 寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0x20	Device ID	VendorID[3:0]				Ver[3:0]				0xd2

VendorID[3:0]: 厂家编码, VendorID[3:0]=1101b=Dh, 代表大普通信。



Ver[3:0]: 芯片版本号, 从 1 开始。

### 6.2.8 控制寄存器 1

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0x21	Control Register 1	保留位: 必须为 0x8				○	○	○	●	0x80

### 6.2.9 亚秒时间寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0x27	SubSEC	保留位				SubSEC[3:0]				0x00

SubSEC[3:0]: 时间亚秒位, 单位为 1/16s。



## 7 I<sup>2</sup>C 总线接口



I<sup>2</sup>C 总线接口通过 SCL、SDA 两根线作双向通信。SCL 是时钟线，SDA 是数据线。I<sup>2</sup>C 设备分为主设备和从设备，INS5710C 只能作为从设备。

### 7.1 注意事项

I<sup>2</sup>C 总线包含 START 命令、STOP 命令，为防止 I<sup>2</sup>C 总线挂死，从 START 命令到 STOP 命令必须在 1 秒内完成。如果超过 1 秒，INS5710C 会重置 I<sup>2</sup>C 接口。

INS5710C I<sup>2</sup>C 总线接口既支持单字节读写寄存器，也支持多字节递增访问。访问地址 0x7F 后，下一个增量地址是 0x00。

### 7.2 总线地址

表12. I<sup>2</sup>C 总线 Slave 地址

Transfer data	Slave address							R/W
	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
65h (Read)	0	1	1	0	0	1	0	1 (Read)
64h (Write)	0	1	1	0	0	1	0	0 (Write)

INS5710C I<sup>2</sup>C 总线 Slave 地址是 [0110 010\*]。

### 7.3 总线协议

本节描述基于 CPU 为 I<sup>2</sup>C 主设备，INS5710C 为 I<sup>2</sup>C 从设备。

#### 7.3.1 写序列

I<sup>2</sup>C 总线接口在写地址确定后，后续访问包含地址自增功能，即 I<sup>2</sup>C 总线接口在写一个字节数据后，自动将后面写数据的地址自增。



- (1) CPU 发送开始[S]
- (2) CPU 发送 I<sup>2</sup>C 总线接口从地址，在 R/W 位设置为写模式
- (3) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口的 ACK
- (4) CPU 发送写地址给 I<sup>2</sup>C 总线接口
- (5) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口的 ACK
- (6) CPU 发送写数据给 I<sup>2</sup>C 总线接口
- (7) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口的 ACK
- (8) 如果写多字节，重复步骤（6）和（7），地址自增
- (9) CPU 发送停止[P]



### 7.3.2 读序列

先用写模式写要读的寄存器地址，然后设置成读模式读取寄存器数据。

- (1) CPU 发送开始[S]
- (2) CPU 发送 I<sup>2</sup>C 总线接口从地址，在 R/W 位设置为写模式
- (3) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口的 ACK
- (4) CPU 发送读地址给 I<sup>2</sup>C 总线接口
- (5) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口的 ACK
- (6) CPU 发送重新开始[Sr]
- (7) CPU 发送 I<sup>2</sup>C 总线接口从地址，在 R/W 位设置为读模式
- (8) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口的 ACK
- (9) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口读到的数据
- (10) CPU 发送 ACK
- (11) 如果读多字节，重复步骤（9）和（10），地址自增
- (12) CPU 发送 ACK
- (13) CPU 发送停止[P]





DAPU Confidential

FOR 大普



## 8 封装尺寸图

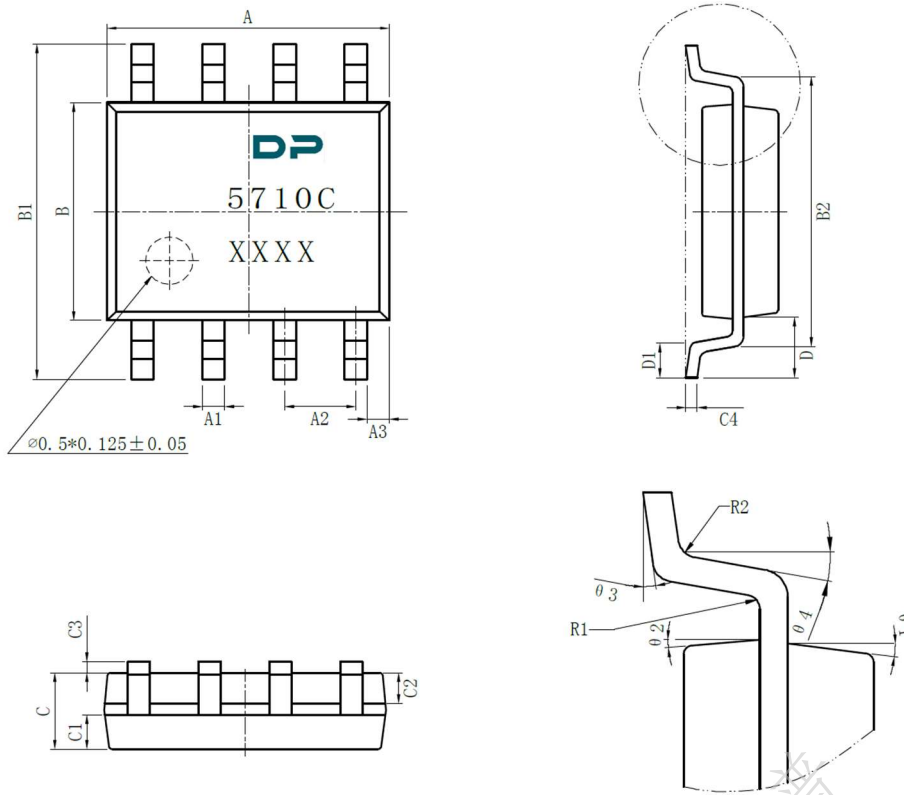


图 3 封装图

Dimension	Min.	Typ.	Max.
A	4.8	4.9	5.0
A1	0.356	--	0.456
A2	--	1.27	--
A3	--	0.345	--
B	3.8	3.9	4.0
B1	5.8	6.0	6.2
B2	--	5.00	--
C	1.3	--	1.6
C1	0.55	--	0.65
C2	0.55	--	0.65

(Unit: mm)

Dimension	Min.	Typ.	Max.
C3	0.05	--	0.20
C4	0.203	--	0.233
D	--	1.05	--
D1	0.4	--	0.8
R1	--	0.2	--
R2	--	0.2	--
θ1	17°		
θ2	13°		
θ3	0°~8°		
θ4	4°~12°		

(Unit: mm)



## 9 回流焊曲线

标准: IPC/JEDEC J-STD-020

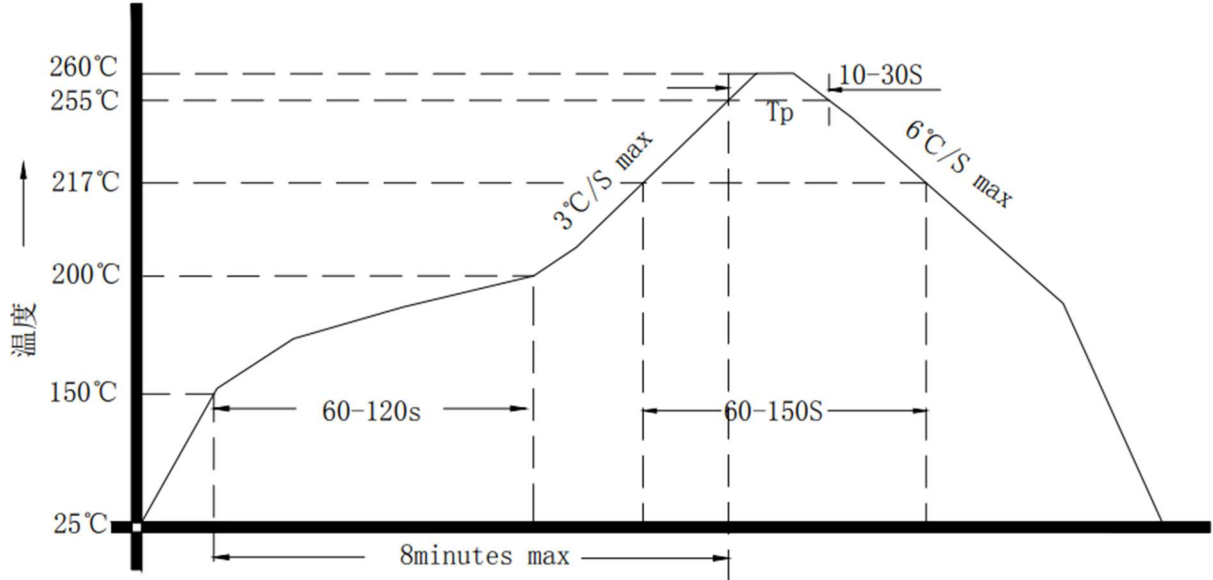
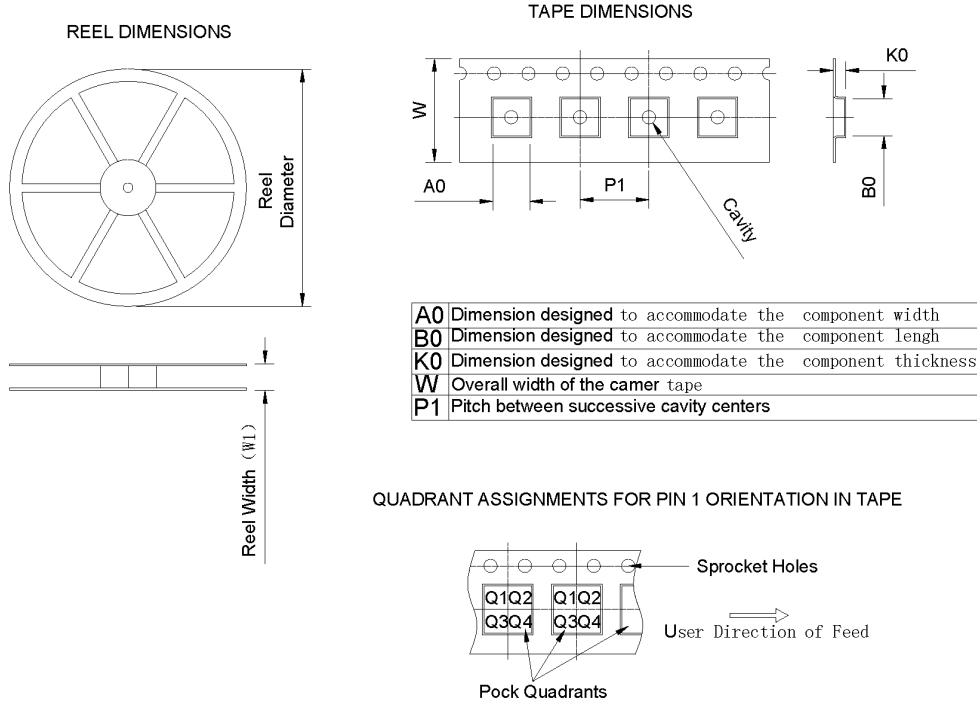


图 4 回流焊曲线

请遵从上图定义的回流焊曲线。当手动焊接时，焊接温度不得超过+260°C，否则会造成内部晶体振荡器的特性退化甚至损坏。由于手焊温度不易控制，建议采用回流焊焊接。



# 10 包装信息



Device	Package Type	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1(mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	PIN1 Quadrant
INS5710C	SOP	8	3000	330±1	12.4±0.2	6.40	5.30	2.10	8.00±0.1	12.00±0.1	Q1

图 5 包装信息